

元器件生产厂商自查承诺书

依据ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》和ZKB 3101-002-2022《WQZB使用国产电子元器件“W、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求,我单位针对研制生产的电子元器件产品开展ZZKK等级和“W、空、包”情况自查及评估。结果如下:

自查产品共6项,其中ZZKKA级0项、B级6项、C级0项、C*级0项、D级0项、E级0项;W国产化0项、BZ国产化0项、KX国产化0项。

电子元器件“W、空、包”审查基本信息填写表详见附表1;

电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表2。

我单位承诺以上内容真实有效,自愿承担一切后果。

特此承诺。

无锡泰连芯科技有限公司(盖章)

2026年01月12日



附表 1 电子元器件“W、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	生产厂商	ZZKK等级	是否“W 国产化”		是否“BZ 国产化”		是否“KX 国产化”		备注
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XC5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	TLX2166XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	TLX2166XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章):  法定代表人(鉴章):  填表人(签字): 侯仕颖 电话:13699386074 填报日期: 20260112

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002附录A填写
2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
4. 生产厂商: 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
5. Wkb: 按照ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》执行, 分为A、B、C、C*、D、E六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照GJB 9530执行;
6. “Wkb” 应按照ZKB3101-002-2022标准执行。若为“是”时, 则需要在“情况说明”写明判别因素; 若为“否”时, 则填“无”;
7. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。



填报单位(盖章): 湖北芯连科技有限公司 法定代表人(鉴章): 侯仕颖 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260112

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	使用 IP 核情况				原材料和零部件				流片工艺		备注
						名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否核心/关键	来源单位	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				
2	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XC5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				
3	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XF5(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				
4	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	JTLX2166XC5(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				

填报单位(盖章): 法定代表人(鉴章): 填表人(签字): 联系电话: 13699386074 填报日期: 20260112

5	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	TLX2166XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				
6	半导体集成电路	通用模拟电路	/	模拟开关	TLX2166XC5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	南通金茂				

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002 附录A填写

2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;

4. 使用IP 核情况: 仅适用于半导体集成电路, 应填写IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;

5. 原材料和零部件: 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含ZKB 3101-002-2022 标准附录A中零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;

6. 是否“核心”/“关键”: 应根据ZKB 3101-002-2022 标准附录A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;

7. 来源单位: 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;

8. 流片工艺: 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如45nmBCD 工艺等;

9. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。

填报单位(盖章):  法定代表人(鉴章):  填表人(签字):  联系电话: 13699386074 填报日期: 20260112